

证券代码：301348

证券简称：蓝箭电子

佛山市蓝箭电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系活动类别	<div><div>☒特定对象调研</div><div>☐分析师会议</div></div> <div><div>☐媒体采访</div><div>☐业绩说明会</div></div> <div><div>☐新闻发布会</div><div>☐路演活动</div></div> <div><div>☒现场参观</div></div> <div><div>☐其他（电话会议）</div></div>
参与单位名称/人员姓名	博时基金、佛山市上市公司协会、个人投资者等
时间	2026年06月25日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：张国光；证券事务代表：林品旺
投资者关系活动主要内容介绍	<div><div>一、参观公司生产线及募投项目</div><div>二、公司董事会秘书张国光先生介绍公司基本情况</div><div>三、互动交流环节</div><div>1. 公司预计今年的营收收入、毛利率变化趋势如何</div><div>回复： 公司 2026 年一季度的营收实现明显同比提升，公司管理层对公司的发展潜力抱有坚定信心，将本着对全体股东负责的态度稳健经营，全力提振公司未来业绩。</div><div>公司毛利率修复将遵循分层渐进节奏推进，短期核心依靠产能利用率提升摊薄单位折旧成本，同步持续优化订单结构，对冲传统封装价格内卷带来的毛利压力。中长期伴随高端工艺良率稳定爬坡、上游存储及功率芯片封测报价传导落地；公司后续若成功并购标的，并表后有高毛利的高可靠模拟芯片业务补充，综合盈利水平将持续抬升。</div><div>2. 公司产品主要的下游应用场景，未来产品结构调整方向</div><div>回复： 公司产品主要应用于消费电子、家电、电源管理、汽车电子、工控等领域。公司的发展路径将紧跟半导体封装测试小型化、集成化、高端化、智能化发展方向，聚焦物联网、可穿戴设备、智能家居、健康护理、安防电子、新能源汽车、储能、智能电网、工业控制、5G 通信射频等具有广阔发展前景的领域，持续强化功率器件、宽禁带功率半导体器件、Clip bond、LQFP 及 BGA 封装工艺、车规级产品、存储芯片封装等领域的研发创新能力；加大晶圆级芯片封装、系统级封装（SIP）投入，在现有 SIP 技术基础上，进一步拓宽封测服务技术边界与产品种类，实现模拟电路、数字电路、传感器、存储芯片等多领域封测能力全覆盖，巩固并提升核心技术壁垒。重点向工业、新能源汽车领域和车规级产品的应用市场进行推广。</div><div>3. 关于公司现有产能和未来产能规划</div><div>回复： 公司具备覆盖 4 英寸-12 英寸晶圆全流程封测能力，截至 2025 年 12 月 31 日，公司产能达到 220 亿只/年的生产规模，产能利用率处于长期温和放量的态势。公司依托已建设完成的募投扩建生产线项目，未来将依据业务发展需要进一</div></div>

	<p>步扩大产能。</p> <p>4. 公司此前参股芯展速、并购成都芯翼的战略考量</p> <p>回复：</p> <p>公司基于目前发展现状及结合长远的发展战略，积极进行半导体产业链上下游布局，包括向上游芯片设计领域先后增资入股派德芯能半导体（上海）有限公司、深圳芯展速科技发展有限公司。</p> <p>其中，公司对芯展速的投资，是结合芯展速在半导体高性能企业级存储主控芯片、企业级 SSD 产品、数据服务领域等优势和公司在封装测试领域的技术与制造能力，有助于公司拓展新的应用场景、丰富产业生态。本次投资是基于半导体产业链协同发展作出的审慎布局，符合公司长期发展方向，有利于提升综合竞争力与抗风险能力。</p> <p>此外，公司拟收购成都芯翼科技有限公司 60%的股权，将成都芯翼纳入公司合并报表范围，逐步构建起“芯片设计+半导体封装测试”相互促进发展的产业链格局。一方面完善产业链布局，提升综合服务壁垒：公司主业聚焦半导体封装测试环节，向上游芯片设计领域延伸后，可形成从芯片前端设计到后端封装交付的全链条服务能力，为客户提供一站式解决方案，强化公司在产业链中的话语权与客户粘性。另一方面打通协同链路，放大业务价值：延伸布局芯片设计主体后，公司可提前介入产品设计阶段，协同优化封装工艺方案，缩短产品研发周期、提升良率与交付效率，同时依托标的设计能力切入高附加值产品赛道，优化整体盈利结构。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年06月25日